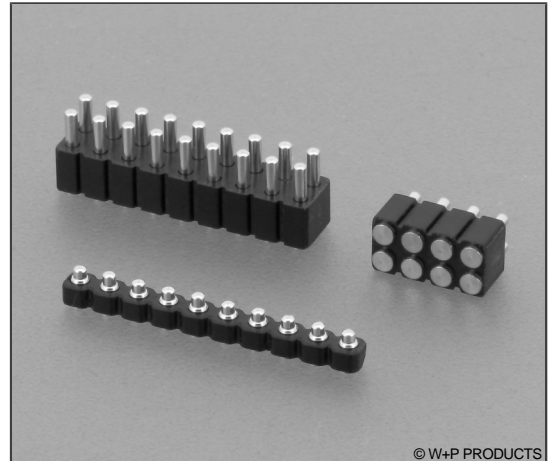
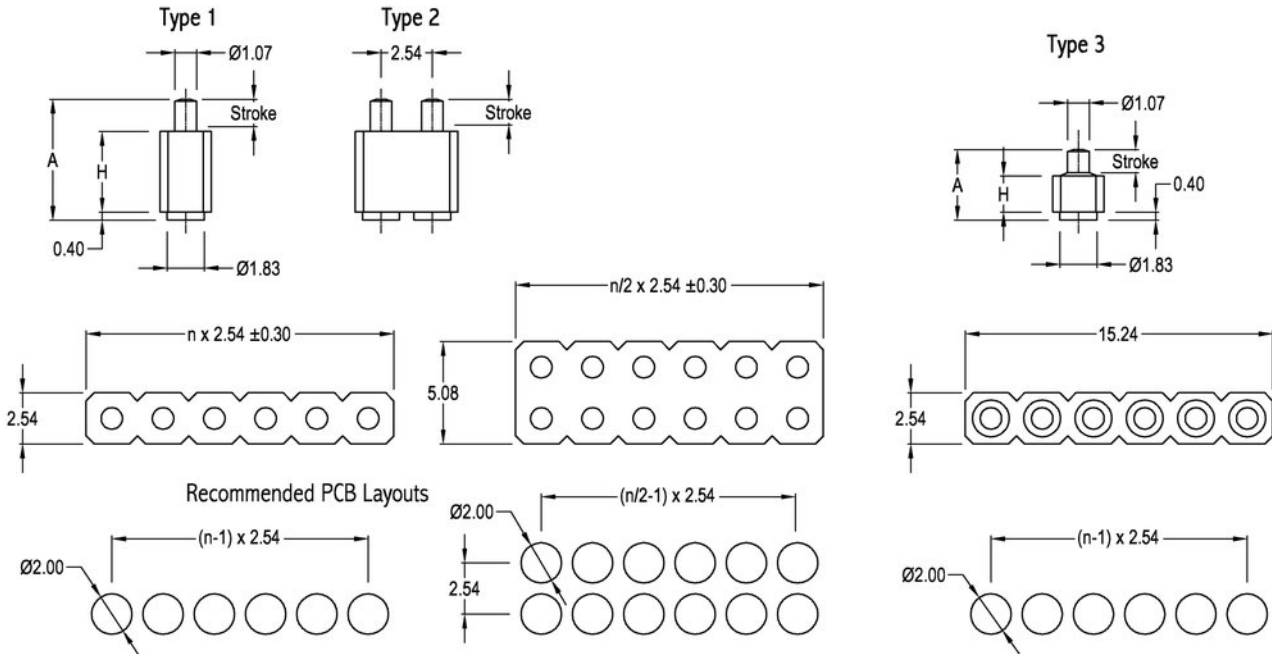


Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, UL94 V-0 <i>Thermoplastic, UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kupferlegierung <i>Copper alloy</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Gold über Nickel (siehe Optionen unten) <i>Gold over nickel (see options below)</i>
Lötbarkeit <i>Solderability</i>	IEC 60512-12A <i>IEC 60512-12A</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 15mΩ <i>< 15mΩ</i>
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000MΩ <i>> 1000MΩ</i>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	3,5A <i>3.5A</i>
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-55°C ... +125°C <i>-55°C ... +125°C</i>
Mechanische Lebensdauer <i>Mechanical Life</i>	> 100 000 Kontaktzyklen (Stroke max. <= 1/2 Stroke) <i>> 100 000 mating cycles (stroke max. <= 1/2 stroke)</i>
Verarbeitung <i>Processing</i>	Reflow-Lötverfahren <i>Reflow soldering</i>



© W+P PRODUCTS



Type	A	Code	H	Stroke
3	3.5	35	1.8	1.0
3	4.5	45	2.95	1.15
3	5.0	50	2.95	1.4
3	5.5	55	2.95	1.4
1 / 2	6.0	60	4.0	1.4
1 / 2	6.5	65	4.0	1.4
1 / 2	7.0	70	4.0	1.4
1 / 2	7.5	75	4.0	1.4

Federkraft / Spring Tension : 0.6N @ 1/2 Stroke

Series 3234	Contacts* 06 02-10 Einreihig Single row 04-20 Zweireihig Double row	Type* 2 1 Einreihig Single row 2 Zweireihig Double row 3 Offener ISK (einreihig) Open body (single row)	Height A* 45 35-75 (lt. Tabelle) (see table)	Plating 20 20 20µ" (0,5µm) Au
------------------------------	--	--	---	---

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150°C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich T_L	217°C
Verweildauer oberhalb T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur T_P	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150°C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature T_L	217°C
Duration above T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature T_P	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	Max. 8min

